

股票代码:688535 股票简称:华海诚科 上市地点:上海证券交易所



# 江苏华海诚科新材料股份有限公司

## 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要

本预案摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:

重组报告书	指	《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》
重组报告书	指	本次交易审计报告等相关工作完成后,就本次交易编制的重组报告书
华海诚科、本公司、公司、上市公司	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司
本次发行、本次重组、本次收购	指	以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购杭州耀辉实业有限公司等13名持有华海诚科公司70%股权并募集配套资金
标的公司、衡所华威	指	衡所华威电子有限公司
标的资产、交易标的	指	衡所华威电子有限公司70%的股权
标的资产、交易标的	指	上海斯所电子有限公司、衡所华威全资子公司 Hysol RM Hysol RM Co., Ltd.、衡所华威全资子公司 Hysol Malaysia
浙江永利	指	浙江永利实业集团有限公司
杭州耀辉	指	杭州耀辉实业有限公司
上海微电子	指	上海微电子装备(集团)股份有限公司
桐梓关友	指	桐梓关友投资有限公司
上海海晏	指	上海海晏投资管理合伙企业(有限合伙)
德邦科技	指	浙江德邦科技股份有限公司(有限合伙)
丹盈瑞宇	指	丹盈瑞宇瑞盈股权投资合伙企业(有限合伙)
鼎宇华天	指	江苏鼎宇华天股权投资合伙企业(有限合伙)
连云港金桥	指	连云港市金桥新兴产业基金合伙企业(有限合伙)
连云港高新	指	连云港瑞盈股权投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴源诚	指	嘉兴源诚源诚股权投资合伙企业(有限合伙)
睿源心联	指	睿源心联(杭州)创业股权投资合伙企业(有限合伙)
南德全德宇	指	南德全德宇德宇二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)
交易对方	指	杭州耀辉实业有限公司等13名
《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》	指	《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》
EMC	指	环氧模具材料(Epoxy Molding Compound)全称为环氧树脂预浸料,是用于半导体制程的一种绝缘材料,由环氧树脂树脂基体、固化剂和填料组成,经模压成型后,加入各种添加剂,以及添加各种添加剂加工而成,主要用于保护半导体芯片不受外界环境(水汽、温度、污染等)的影响,并实现导热、绝缘、耐压、支撑等复合功能。
环氧树脂	指	一种高分子聚合物,分子式为(C11H19O3)n,是由分子中含有两个以上环氧基团的一类化合物的统称,它是环氧树脂与固化剂多元醇的缩聚产物,又名环氧树脂,为无色或琥珀色透明物,市场销售往往着色而呈现黄、棕、红、蓝、紫等颜色,具有优良的物理机械性能、耐热稳定性和耐化学腐蚀性,不溶于水,溶于丙酮、酒精等有机溶剂中,由环氧树脂及其衍生物聚合而成。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
公司章程	指	《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》
股东大会	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

除特别说明外,均为预案摘要中所有数据(保留两位小数),若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

### 一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性,相关资产评估师出具的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的真实性判断,不构成任何投资建议,投资者应自行承担投资风险。

交易类型	交易对方名称
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产	杭州耀辉实业有限公司等13名衡所华威电子有限公司股东
募集配套资金	不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者

二零二四年十一月

同时披露的相关内容,本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素:

一、本次交易相关风险

(一)审批风险

本次交易已经满足中国证监会第三十三号令第二十一条、第三十三条和第三十四条规定,但本次交易尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:

1、本次交易相关资产的审计、评估工作完成后,尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案;

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案;

3、本次交易正式方案尚需经交易对方内部有权机构审议通过;

4、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册;

5、各方根据相关法律法规履行其他必要的审批/备案程序(如适用)。

本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册,以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间,均存在不确定性。因此,若本次重组无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件,则本次重组可能由于无法推进而取消,公司提请广大投资者注意投资风险。

(二)本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易涉及面广,中国证监会等相关监管机构的审核审批流程复杂,上述工作能否如期顺利完成对本次交易的时间进度存在重大影响。除此之外,本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险;

2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧,而被暂停、中止或取消的风险;

3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件,而被暂停、中止或取消的风险;

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、中止或取消,特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中,及时公告相关工作进展,以便投资者了解本次交易进展,并做出相应判断。

(三)审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成,标的资产的评估及交易作价尚未确定。本预案摘要引用的标的公司主要财务指标、经营业绩存在后续调整的可能,仅供参考。

相关数据符合符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司的审计、评估工作尚未完成,评估结果将在重组报告书中予以披露,提请投资者注意,相关数据经审计的财务数据可能与本预案摘要披露情况存在较大差异的风险。

(四)交易作价尚未确定的风险

截至本预案摘要签署日,本次交易的初步方案已确定,但基于本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易的标的资产的交易价格尚未确定,标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易各方协商一致后确定,最终评估结果将在重组报告书中予以披露。提请广大投资者注意相关风险。

(五)本次交易方案调整的风险

截至本预案摘要签署日,本次重组标的资产的审计、评估及对标的公司全面深入了解工作尚未完成,交易各方仍在就本次交易的相关事宜进行磋商,标的公司财务状况和完整情况尚待进一步核实,本预案摘要披露的方案仅为本次交易的初步方案,最终方案将在重组报告书中予以披露。本次交易存在方案调整后调整的可能性。

(六)本次交易可能被摊薄的风险

由于本次交易规模的审计、评估工作尚未完成,无法对本次交易完成后上市公司的合并财务状况和盈利能力进行准确的定量分析。本次交易实施完成后,上市公司归属于母公司普通股股东的净利润可能增加,但本次交易后,上市公司的总股本也将增加,从而可能导致公司每股收益被摊薄,公司将在重组报告书中予以详细分析,提请投资者关注本次交易可能被摊薄的风险。

(七)商誉减值的风险

本次交易完成后,收购的标的公司相应股权权益的可辨认净资产公允价值,预计将形成商誉。若标的公司未来经营业绩不佳,则公司可能出现商誉减值风险,对当期损益造成不利影响。

(八)募集配套资金不达预期的风险

作为交易方案的一部分,上市公司拟募集配套资金。若因法律法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见,上市公司将按最新规定进行监管意见进行应对调整。上述募集配套资金能否取得交易所审核通过,证监会的注册审批存在不确定性。此外,若股价波动或市场环境变化,可能存在本次募集配套资金不足乃至募集失败的风险。

(九)收购整合的风险

本次交易完成后,标的资产将纳入上市公司管理及合并范围,上市公司的业务规模、人员等将进一步整合,上市公司将面临经营管理方面的挑战,提请投资者关注相关风险。

二、与标的公司相关的风险

(一)下游需求下滑及半导体行业产能过剩的风险

标的公司主要从事半导体芯片封装材料研发及产业化,其下游市场需求受到全球宏观经济波动、国际地缘政治和产业政策等因素影响。若全球宏观经济下行,下游行业产能过剩或出现产能过剩,或半导体行业下行且持续时间较长、幅度较大,可能对标的公司的整体经营业绩造成不利影响。

(二)国际贸易摩擦的风险

近年来国际经贸经济日益复杂,国际贸易摩擦不断升级。有关国家针对半导体行业出台了一系列限制措施,对全球半导体供应链造成一定冲击。若国际贸易摩擦进一步加剧,标的公司可能面临经营受阻、订单减少或供货不稳定等风险,其正常经营可能受到不利影响。

(三)市场竞争加剧风险

标的公司主要从事环氧封装材料,与外资主要厂商存在直接竞争关系,且随着中国大陆半导体产业的日益完善,终端应用市场的不断增长以及国产替代进程的加快,市场将可能出现新的半导体封装材料企业,标的公司将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争。若标的公司不能在产品研发、技术升级、人才培养等方面持续创新突破,不能根据客户需求及时推出新产品及提升升级,标的公司无法持续保持竞争优势,从而对公司的行业地位、市场份额、核心竞争力产生不利影响。

(四)核心技术人员流失风险

技术研发及研发人才等均为标的公司所从事的核心资源之一,优秀的研发团队是标的公司的核心竞争力及未来发展基础。目前标的公司主要管理层及研发团队在所处行业深耕多年,拥有丰富的产品研发经验,其产品及技术得到市场和业界的一致认可。但随着竞争的加剧,人才竞争将更加激烈,若标的公司不能提供较好的职业发展、有吸引力薪酬待遇及相应的激励机制,将面临核心技术人员流失的风险。

(五)重点客户同类产品市场竞争加剧的风险

上市公司与客户均从事半导体芯片封装材料业务,在市场开发、客户等方面存在较强的协同效应,但同时由于存在部分客户重叠的情形,本次交易完成后,上市公司与标的公司对同一客户同类产品总体出货量可能集中于公司在采购时基本分散采购,供应商集中度将有所提高,存在一定的风险。

(六)境外子公司管理和控制风险

本次交易完成后,公司将整合标的公司在韩国、马来西亚子公司的研发、客户等资源,利用境外公司在先进封装的应用经验、客户资源及技术支持等优势,加速推进公司在先进封装领域的拓展,随着境外子公司生产经营规模的扩大,境外经营环境的变化等因素影响,使得对公司的境外子公司在人力资源管理、产品质量控制、资源调配等方面面临挑战,也对管理的有效性提出了更高的要求。如果未来无法根据业务发展需求持续提高管理水平与管理效率,对标的公司境外子公司的管理和控制将面临一定风险。

### 第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

1、产业整合对半导体封装材料产业发展具有战略意义

半导体封装材料是半导体产业的基础,根据中国科学院半导体研究所与信息技术研究所SIMT战略研究中心的《我国集成电路材料专题研究报告》,90%以上的半导体芯片封装材料均采用环氧封装材料,因此,环氧封装材料已成为半导体产业发展的关键支撑产业。

基于下游封装技术、应用规模以及性能特征的不同,环氧封装材料分为高导热、高性能类、先进封装类。在当下行业格局中,高性能类处于主导地位。近年来,随着集成电路封装工艺已接近物理尺寸的限制,集成电路行业进入了“摩尔定律”放缓,通过先进封装技术提升芯片整体性能已成为趋势,因此先进封装技术已成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术预计在整个封装市场占比逐步提升。

结合下游封装技术的发展趋势,对先进封装材料的需求持续提升并开展研发工作,已通过部分客户验证。为了快速推进在先进封装环氧封装材料领域的领先地位,公司拟通过收购的形式加强与先进封装技术资源、客户资源的整合,加快布局未来主流发展方向上的芯片封装材料,同时优化产品结构,客户结构,提升公司的国际竞争力及全球影响力,打破国外竞争对手在先进封装材料上的垄断,对我国半导体封装材料产业发展具有战略意义。

2、国内半导体供应链安全需求迫切

我国半导体产业链中,半导体材料位于上游环节,为半导体制造工艺的关键环节。目前,我国半导体封装材料国产化程度较低,其中高性能类国产化率仅15%左右,先进封装材料国产化率更低,基本被国外企业垄断,进口替代空间广阔。并购有利于双方在市场、客户、技术和产品等方面的资源整合,对双方研发、生产、销售、供应链资源等方面进行优化,为保障我国半导体供应链安全发展提供有力支撑。

3、半导体封装材料市场前景广阔

环氧封装材料是半导体产业中应用最广泛的基础材料,半导体可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、5G信息通信、工业控制、物联网等各个领域,随着半导体在上述新兴领域市场需求逐步扩大,环氧封装材料市场增长空间较大。根据SIMT的数据,预计2024年全球封装材料市场规模约60.17亿美元,市场规模约80.4亿美元,其中,封装材料市场规模约38.7亿美元,增4.79%。另外,封装材料行业半导体产业支撑发展状况报告预测2024年国内封装材料市场规模约69.6亿元,增长1.98%。

同时,随着我国与全球各地经济体系的深度融合,许多国家和地区都不同程度的加强半导体自主化发展战略,强化对半导体产业的投资和研发。高性能类先进封装环氧封装材料目前主要由外资厂商垄断,依赖进口,长期用于“卡脖子”产品,国产替代空间广阔。

4、国家高度重视支持半导体材料产业发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“坚持创新驱动我国现代化建设的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。集成电路产业作为关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性新兴产业,核心技术发展和科技创新有助于增强国家在高科技领域的竞争力,提高国家整体效能。半导体材料作为集成电路产业的基础,在集成电路制造技术不断升级和产业的持续创新发展中扮演着重要角色。我国的半导体材料相较于美国、日本、韩国等国起步较晚,与业界龙头企业存在一定差距。

国家高度重视半导体材料产业的高质量发展,一方面,近年来密集出台了多项支持政策,鼓励和支持半导体材料产业发展,为半导体企业提供了财政补贴、税收优惠、研发费用等多方面支持;另一方面,近期政策高度重视支持通过并购重组进行产业升级,加强资源整合,支持补链强链,有助于提升我国半导体材料产业在全球产业链中的核心竞争力。

(二)本次交易的目的

本次交易旨在通过收购标的公司,整合全球先进封装材料封装材料企业

本次交易实施前,上市公司、标的公司分别属于半导体封装材料国内厂商出货量第二、第一位。本次交易完成后,上市公司在半导体环氧封装材料的年产量有望突破25,000吨,稳固国内龙头地位,跃居全球第二位。同时,本次交易有利于上市公司生产和销售基地延伸至韩国、马来西亚,成为世界领先的半导体封装材料企业。

2.本次交易实施后,上市公司、标的公司借助标的公司品牌优势跨越式发展

标的公司所持有的(Hysol)品牌拥有二十一年品牌积淀,积累了一批全球知名的半导体客户,如安世半导体(Nexperia)、意法半导体(ST Microelectronics)、英飞凌(Intelium)、日新(ATX)、艾维克斯(AVX)、基美(KEMET)、力特半导体(Littelluse)、安美斯(Osmel)、德州仪器(TI)等。本次交易如能成功,有利于上市公司直接获取上述客户资源,快速提升国际市场份额,提高国产半导体封装材料的国际竞争力。

二、本次交易的交易对方

本次交易实施前,上市公司、标的公司分别属于半导体封装材料国内厂商出货量第二、第一位。本次交易完成后,上市公司在半导体环氧封装材料的年产量有望突破25,000吨,稳固国内龙头地位,跃居全球第二位。同时,本次交易有利于上市公司生产和销售基地延伸至韩国、马来西亚,成为世界领先的半导体封装材料企业。

三、本次交易涉及的信息披露义务

上市公司将根据中国证监会及上交所的有关规定,为参加股东大会的股东提供便利,在表决本次交易方案的股东大会上,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,充分保障中小股东依法行使投票权权益。

(四)分别披露收购对价损益

上市公司将对本次收购者表决权情况单独统计,并统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

(五)确保本次交易的定价公平、公允

上市公司将聘请符合相关法律法规要求的审计、评估机构对标的资产进行审计、评估,确保标的资产定价符合上市公司独立董事专门会议对于本次交易涉及的定价公允性的公允性发表独立意见。此外,上市公司将聘请法律顾问、法律顾问等中介机构,对本次交易出具专业意见,确保本次交易定价公平、公允,合理,不损害其他股东的利益。

(六)本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排

截至本预案摘要签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,公司将在审计、评估工作完成后,结合上市公司财务报表,标的公司未经营数据,合理测算本次交易对每股收益的影响,并及时补充回报安排在重组报告书中予以披露。

七、待补充披露的信息提示

截至本预案摘要签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,标的资产定价及交易作价尚未确定。本次交易的标的资产的最终评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。相关资产评估师的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告为基础的评估结果为基础,经交易各方协商一致并在重组报告书中予以披露。

重大风险提示

在评价本公司本次交易或作出投资决策时,除本预案摘要的其他内容和与本预案摘要

交易类型	交易对方名称
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产	杭州耀辉实业有限公司等13名衡所华威电子有限公司股东
募集配套资金	不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者

二零二四年十一月

同时披露的相关内容,本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素:

一、本次交易相关风险

(一)审批风险

本次交易已经满足中国证监会第三十三号令第二十一条、第三十三条和第三十四条规定,但本次交易尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:

1、本次交易相关资产的审计、评估工作完成后,尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案;

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案;

3、本次交易正式方案尚需经交易对方内部有权机构审议通过;

4、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册;

5、各方根据相关法律法规履行其他必要的审批/备案程序(如适用)。

本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册,以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间,均存在不确定性。因此,若本次重组无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件,则本次重组可能由于无法推进而取消,公司提请广大投资者注意投资风险。

(二)本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易涉及面广,中国证监会等相关监管机构的审核审批流程复杂,上述工作能否如期顺利完成对本次交易的时间进度存在重大影响。除此之外,本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险;

2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧,而被暂停、中止或取消的风险;

3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件,而被暂停、中止或取消的风险;

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、中止或取消,特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中,及时公告相关工作进展,以便投资者了解本次交易进展,并做出相应判断。

(三)审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成,标的资产的评估及交易作价尚未确定。本预案摘要引用的标的公司主要财务指标、经营业绩存在后续调整的可能,仅供参考。

相关数据符合符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司的审计、评估工作尚未完成,评估结果将在重组报告书中予以披露,提请投资者注意,相关数据经审计的财务数据可能与本预案摘要披露情况存在较大差异的风险。

(四)交易作价尚未确定的风险

截至本预案摘要签署日,本次交易的初步方案已确定,但基于本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易的标的资产的交易价格尚未确定,标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易各方协商一致后确定,最终评估结果将在重组报告书中予以披露。提请广大投资者注意相关风险。

</